

关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案 的半年度评估报告

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2026 年 3 月 14 日发布《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，为公司 2026 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2026 年上半年的具体执行情况进行汇报：

一、PCB、泛半导体双赛道景气度提升，A+H 平台赋能全球化新征程

2026 年上半年，在 AI 基础设施扩建浪潮的推动下，AI 数据中心、服务器等需求量激增，带动 PCB 和半导体行业快速发展，公司各产品线订单饱满。公司坚守“技术平台化、市场全球化、运营精益化”核心战略，依托自主可控的微纳直写光刻底层技术平台，实现 PCB 高端设备基本盘稳健扩容、泛半导体先进封装设备第二曲线爆发式增长的双轮驱动格局。

报告期内，公司一、二期生产基地协同满产运行，订单储备、整机交付规模、海外营收规模及高端新品产业化落地进度，同步表现优秀；A+H 双重资本平台顺利落地，全球化研发、销售与产能布局全面提速，经营质量、技术壁垒、客户结构、资本实力同步实现跨越式提升，全球直写光刻设备龙头地位进一步巩固。

1、PCB 业务：高阶 LDI 设备占比提升，激光钻孔设备小批量交付

公司是国内极少数满足 AI 服务器及数据中心严苛标准的高端 LDI 设备供应商，具备量产供货能力并进入行业头部客户供应链，已成功实现了对该类设备的国产化替代，确立了在高性能计算基础设施制造环节的领先优势与独占地位。

在 PCB 曝光机业务中，受益于 AI 服务器、智能驾驶、先进封装等领域需求持续放量，高阶产品订单保持强劲增长，市场竞争力进一步凸显，高端线路机型 MAS12 需求旺盛。公司持续深化大客户价值共创战略，与鹏鼎控股、胜宏科技、沪电股份、深南电路、景旺电子、东山精密、生益电子、定颖电子、红板科技等

PCB 行业龙头深化战略协同，构建长期稳定深度产业伙伴关系。公司高端设备有效提升客户制程良率与单位产能产出，头部客户年度采购规模持续增长，推动公司在全球直写 LDI 设备市场占有率稳步提升，客户结构持续向高端、高粘性头部厂商集中。

激光钻孔业务方面，公司拥有适配 AI 算力场景的先进材料激光钻孔解决方案，可为 AI PCB 与高端载板打造贯通激光钻孔、激光直接成像的全套制程方案。公司自主研发 CO₂高精度激光钻孔设备依托统一直写算法平台，集成实时位置校准、孔型在线检测、能量闭环监控三大核心功能，微孔与线路对位精度行业领先。2025 年末设备完成头部 PCB 厂量产验证后，2026 上半年实现稳定批量交付，客户端良率、稳定性数据获得全产业链认可，陆续斩获多家全球百强 PCB 企业复购订单。

2、泛半导体业务：载板设备需求量高涨，先进封装下游扩产提速

2026 年载板行业供需缺口加大，AI 服务器和高速网络将推动对大尺寸芯片及先进封装的需求，将推动 IC 载板市场规模持续保持高增长。此外，PCB 载板化趋势明显。随着数据中心从 400G、800G 向 1.6T、3.2T 高速光模块升级，信号传输速率的指数级提升对物理互连提出更高要求。普通 PCB 已难以满足高速信号传输需求，下游厂商开始布局光模块所需的类载板（SLP）产能，该类产品使用改良型半加成法（mSAP），该工艺能够实现更高精度的线路图案。此外，CoWoP（Chip on Wafer on PCB）技术将 HDI 板和 IC 载板合二为一，亦需使用 mSAP 工艺来制造类载板。类载板需使用更高阶的曝光设备，给设备厂商带来新一轮的发展机遇。公司针对 IC 载板现已开发出 MAS2、MAS4、MAS6、MAS8 系列产品，MAS2 已经实现了 2 μm 线宽，达到海外一流竞品水平，单台设备价值量大幅提升；明星产品 MAS6P 获头部客户一致好评，市场订单供给紧俏。

在人工智能、高性能计算（HPC）、5G 和自动驾驶的推动下，先进封装市场规模实现快速增长，报告期内公司下游先进封装客户扩产意愿积极，直写光刻技术凭借无掩模、高分辨率及工艺灵活性优势，在先进封装制造中地位日益重要。公司自主研发的晶圆级光刻设备 WLP 2000P，最小解析半径为 2 μm，目前已成功导入多家先进封装厂商生产线，完成多项工艺验证，逐步实现规模化量产，推动产业技术升级和良率提升；公司自主研发的面板级直写光刻设备 PLP 2000 成功获

得客户订单，PLP 2000 专为大尺寸板级封装应用场景开发，最大可支持 600×600mm 板级加工尺寸，能够满足 CoPoS、玻璃基板、FOPLP 等先进封装工艺对 2 μ m 量产解析能力的要求，该产品的突破，有助于补齐我国先进封装产业链在板级曝光关键装备环节的短板，推动形成更加完整、自主、可控的板级制造装备生态。

二、持续加强研发创新，加快研发成果转化

公司始终重视自主研发与技术积累，报告期内公司研发费用达 6,371 万元，同比增长 4.53%，累计获得授权专利 307 项，其中，已授权发明专利 101 项、已授权实用新型专利 137 项、授权外观设计专利 13 项。此外，公司拥有软件著作权 56 项，形成了覆盖核心算法、光学系统、精密控制、整机集成等方向的自主知识产权体系。同时，公司已形成了系统集成技术、光刻紫外光学及光源技术、高精度高速实时自动对焦技术、高精度高速对准多层套刻技术、高精度多轴高速大行程精密驱动控制技术、高可靠高稳定性 ECC 技术、高速实时高精度图形处理技术等一系列直写光刻领域关键核心技术，构建起完整且具有自主可控的技术平台。在技术成果转化与产品落地方面，公司深度联动市场、客户与产业需求，持续推进产品创新与迭代升级。一方面，不断推动设备向更高光刻精度、更高制程能力方向升级；另一方面，围绕客户实际应用需求，打造高效稳定、小型化集成化的高端装备；同时，前瞻布局新兴赛道，从研发创新与产能扩张双轮驱动 PCB 设备高端化升级，重点加快 PCB 钻孔设备与先进封装设备规模化应用，并积极高端阻焊市场 NEX 系列直写光刻设备，持续拓展应用场景至 FPD 制造、IC 载板、OLED、新型显示、掩模版制版等多元领域，不断完善高端装备产品矩阵，夯实多赛道协同发展格局。通过技术、产品与产业的深度融合，公司核心技术优势持续巩固提升，多款产品关键技术指标已达到或超越国际同类厂商水平，具备突出的市场竞争力与国产替代能力。

三、坚守价值创造初心，持续提升股东回报

公司秉持“价值创造为本、利益共享为纲”的核心发展理念，构建起资本市场回报与战略发展深度协同的双向赋能机制，全年持续强化价值创造，通过现金分红、长效激励等多种方式，提升股东回报，实现公司、股东与核心团队的利益共享、风险共担。

2026 年上半年，公司积极落实“提质增效重回报”专项行动，稳步推进 2025 年度利润分配方案的实施工作。根据预案，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)，合计派发 9,221.85 万元，占 2025 年度归母净利润的 31.81%。此举旨在持续以真金白银回馈全体股东，在保障公司长期研发扩张与全球化布局的同时，切实平衡并提升股东的当期收益。报告期内，公司持续健全内控与信息披露体系，不断提升规范化治理水平，为分红等股东回报机制的规范运作提供坚实保障。

报告期内，公司常态化开展投资者交流活动，向资本市场清晰传递高端 PCB 与先进封装双赛道的成长逻辑，强化市场对公司长期价值及分红回报可持续性的认知，推动市值表现与经营业绩的协同增长。

四、高度重视投资者关系，积极履行信息披露义务

公司高度重视投资者关系管理，建立了多元化的投资者沟通渠道。报告期内，在定期报告披露后，公司参加上海证券交易所主办的十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。同时积极通过上市公司公告、上证 E 互动、股东会、现场调研、投资者热线电话和邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。未来，公司将持续深化投资者关系管理，确保 A+H 两地市场投资人能更直接、更深入的了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。

五、强化公司治理建设，护航稳健发展

报告期内，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善公司治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体如下：

1、优化修订制度体系，深耕规范公司治理

报告期内，公司持续完善公司治理，及时制定并修订多项核心制度。公司第三届董事会四次会议审议通过了《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，确立了公开、公正、公平的薪酬与绩效考核原则，强调与公司长远利益、效益及业绩目标、实际经营情况相结合，权、责、利相结合，激励与约束并重；公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，确立了价值创造、信息透明、依法合规、长期主义、系统性和诚实守信六大基本

原则，强化了以提升公司投资价值、规范市值管理行为、维护公司及投资者合法权益的目的。

2、重视董高合规履职能力建设，强化公司“关键少数”责任

公司一直高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督，积极组织董事、高级管理人员积极参与上交所等监管机构举办的各类合规培训，持续加强证券法律法规、监管规则及公司治理专业知识学习，不断提升合规自律意识与规范履职能力，保障公司持续规范运作。未来公司将持续为董高参与各类专业合规培训提供全力支持，夯实公司规范治理的核心基础。

六、完成 A+H 双重上市布局，全球化资本平台赋能长期战略扩张

报告期内，公司国际化资本运作实现里程碑突破：公司 H 股股票于 6 月 26 日正式在香港联交所主板挂牌上市（股份代号：9630.HK），2026 年 7 月 10 日，公司悉数行使 H 股超额配股权，超额配售权行使后，本次共发行 H 股股份 14,764,400 股，合计募集资金超 36 亿港元，成功搭建 A+H 双资本运作平台。本次 H 股募集资金将重点投向四大战略方向：一是夯实核心研发实力，加快新品迭代落地，开拓多元下游应用场景；二是扩充整体产能规模，加码东南亚核心生产基地建设与设备投入；三是战略性产业投资及并购整合，把握产业链横向、纵向拓展契机，强化自研技术壁垒，稳定上游关键原材料供应保障；四是扩张全球市场业务版图，搭建完善海外销售与本地化技术服务网络。

A+H 双上市平台为公司带来多重战略价值：依托香港国际金融中心拓宽低成本跨境融资渠道，优化资本结构、对冲海外业务汇率波动风险；接轨国际资本市场治理标准，显著提升全球品牌影响力与海外客户认可度；充足资本储备支撑长期研发与全球化扩张，助力公司从国内设备制造商向全球微纳制造整体解决方案提供商全面升级，为长期全球化竞争构建资本核心优势。同时两地双重监管体系推动公司内控、信息披露、合规管理全面升级，实现经营治理规范化、国际化同步提升。

七、提质增效强主业，规范治理重回报

公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和

义务，维护公司良好市场形象，促进公司的平稳健康发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2026年8月26日